



2024年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2024年1月11日

上場会社名 ローツェ株式会社 上場取引所 東
コード番号 6323 URL <https://www.rorze.com>
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 藤代 祥之
問合せ先責任者 (役職名) 管理部長 (氏名) 伊勢村 英一 (TEL) 084-960-0001
四半期報告書提出予定日 2024年1月15日 配当支払開始予定日 —
四半期決算補足説明資料作成の有無：有
四半期決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

1. 2024年2月期第3四半期の連結業績（2023年3月1日～2023年11月30日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年2月期第3四半期	65,162	△8.7	15,763	△11.1	21,326	△20.0	15,487	△21.2
2023年2月期第3四半期	71,382	53.2	17,739	64.6	26,652	122.7	19,666	125.7

(注) 包括利益 2024年2月期第3四半期 20,723百万円 (△20.0%) 2023年2月期第3四半期 25,893百万円 (134.7%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年2月期第3四半期	879 05	877 43
2023年2月期第3四半期	1,138 05	1,135 91

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2024年2月期第3四半期	153,595	96,955	58.3
2023年2月期	126,482	74,795	53.9

(参考) 自己資本 2024年2月期第3四半期 89,617百万円 2023年2月期 68,222百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年2月期	—	0 00	—	135 00	135 00
2024年2月期	—	0 00	—		
2024年2月期（予想）				135 00	135 00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

3. 2024年2月期の連結業績予想（2023年3月1日～2024年2月29日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	88,026	△6.9	21,619	△18.2	21,553	△29.0	15,718	△26.5	892 13

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無
新規 一社（社名）、除外 一社（社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更：無
- ② ①以外の会計方針の変更：無
- ③ 会計上の見積りの変更：無
- ④ 修正再表示：無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2024年2月期3Q	17,640,000株	2023年2月期	17,640,000株
② 期末自己株式数	2024年2月期3Q	19,791株	2023年2月期	358,747株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2024年2月期3Q	17,618,981株	2023年2月期3Q	17,281,305株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述について）

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料2ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書.....	5
四半期連結包括利益計算書.....	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(セグメント情報等)	7
3. 補足情報	8
生産、受注及び販売の状況.....	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、国際情勢が一段と不安定化している中で、物価高による個人消費の弱含みや世界経済の減速懸念などが強まり、景気回復は足踏み状態となりました。

当業界におきましては、短期的には、半導体メーカーによる一時的な在庫調整や設備投資の先送りの動きが見られました。しかし、中長期的には、生成系AI、5G、IoTなどの情報通信技術の発展や、それに伴うデータセンターの能力拡張など半導体市場の力強い成長が見込まれ、世界各地域では半導体関連の工場建設の計画が進展しております。

このような状況の中、当社グループにおきましては、第1四半期連結会計期間では半導体メーカーの設備投資計画の先送り等の影響を受け、売上は低調に推移しました。しかし、第2四半期連結会計期間以降、主に中国向け及び米国向けにおいて需要が回復基調で推移しました。

この結果、当第3四半期連結累計期間における経営成績は、売上高65,162百万円（前年同期比8.7%減）、営業利益15,763百万円（前年同期比11.1%減）、経常利益は為替の影響も受け、21,326百万円（前年同期比20.0%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益15,487百万円（前年同期比21.2%減）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

半導体・FPD関連装置事業の売上高は64,861百万円（前年同期比8.8%減）、セグメント利益は16,311百万円（前年同期比11.1%減）となりました。

ライフサイエンス事業につきましては、売上高は300百万円（前年同期比21.0%増）、セグメント損失は115百万円（前年同期はセグメント損失116百万円）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

当第3四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ27,112百万円増加し、153,595百万円となりました。これは主に、棚卸資産の増加14,014百万円及び現金及び預金の増加8,439百万円によるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ4,952百万円増加し、56,640百万円となりました。これは主に、借入金の増加4,080百万円によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ22,159百万円増加し、96,955百万円となりました。これは主に、利益剰余金の増加13,154百万円、為替換算調整勘定の増加4,381百万円及び資本剰余金の増加3,761百万円によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2024年2月期の通期連結業績予想につきましては、2023年4月11日公表の「2024年2月期決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載しております予想数値から変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年2月28日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年11月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	28,292	36,731
受取手形及び売掛金	26,722	21,963
商品及び製品	2,778	5,099
仕掛品	14,067	16,074
原材料及び貯蔵品	25,988	35,675
その他	2,150	2,659
貸倒引当金	△12	△36
流動資産合計	99,986	118,168
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	10,398	11,484
機械装置及び運搬具(純額)	6,209	6,219
土地	4,415	4,703
その他(純額)	1,079	903
有形固定資産合計	22,102	23,310
無形固定資産		
のれん	—	4,566
その他	643	666
無形固定資産合計	643	5,233
投資その他の資産		
投資有価証券	1,369	2,245
退職給付に係る資産	189	205
繰延税金資産	1,290	1,626
その他	954	2,867
貸倒引当金	△53	△60
投資その他の資産合計	3,749	6,883
固定資産合計	26,496	35,427
資産合計	126,482	153,595

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年2月28日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年11月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	7,350	6,538
短期借入金	14,936	16,005
未払法人税等	4,268	2,498
賞与引当金	1,021	1,448
役員賞与引当金	72	3
製品保証引当金	1,287	1,279
その他	4,107	6,822
流動負債合計	33,044	34,596
固定負債		
長期借入金	17,887	20,898
役員退職慰労引当金	306	421
退職給付に係る負債	67	69
資産除去債務	272	316
繰延税金負債	105	159
その他	3	177
固定負債合計	18,643	22,043
負債合計	51,687	56,640
純資産の部		
株主資本		
資本金	982	982
資本剰余金	1,470	5,231
利益剰余金	61,221	74,376
自己株式	△55	△3
株主資本合計	63,619	80,588
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	153	198
為替換算調整勘定	4,449	8,830
その他の包括利益累計額合計	4,602	9,029
新株予約権	85	85
非支配株主持分	6,487	7,252
純資産合計	74,795	96,955
負債純資産合計	126,482	153,595

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年11月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年11月30日)
売上高	71,382	65,162
売上原価	47,551	41,403
売上総利益	23,831	23,759
販売費及び一般管理費	6,092	7,995
営業利益	17,739	15,763
営業外収益		
受取利息	8	44
受取配当金	8	8
為替差益	9,742	5,724
売電収入	50	42
その他	206	246
営業外収益合計	10,016	6,066
営業外費用		
支払利息	36	54
売電費用	19	20
デリバティブ損失	1,028	386
その他	19	42
営業外費用合計	1,103	504
経常利益	26,652	21,326
特別利益		
固定資産売却益	11	2
特別利益合計	11	2
特別損失		
固定資産売却損	—	0
固定資産除却損	5	7
特別損失合計	5	7
税金等調整前四半期純利益	26,658	21,321
法人税、住民税及び事業税	6,007	5,618
法人税等調整額	69	△243
法人税等合計	6,077	5,374
四半期純利益	20,580	15,946
非支配株主に帰属する四半期純利益	913	458
親会社株主に帰属する四半期純利益	19,666	15,487

(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年11月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年11月30日)
四半期純利益	20,580	15,946
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	9	44
為替換算調整勘定	5,303	4,732
その他の包括利益合計	5,312	4,777
四半期包括利益	25,893	20,723
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	24,766	19,914
非支配株主に係る四半期包括利益	1,127	809

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項
 (継続企業の前提に関する注記)
 該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当社は、2023年1月6日開催の取締役会決議に基づき、2023年3月2日付で、当社を株式交換完全親会社、株式会社イアスを株式交換完全子会社とする株式交換による自己株式338,976株の処分を行っております。この結果、第1四半期連結会計期間において資本剰余金が3,761百万円増加し、自己株式が52百万円減少し、当第3四半期連結会計期間末において資本剰余金が5,231百万円、自己株式が3百万円となっております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当第3四半期連結累計期間(自 2023年3月1日 至 2023年11月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	四半期 連結財務諸表 計上額 (注) 2
	半導体・ FPD関連 装置事業	ライフ サイエンス 事業	計		
売上高					
日本	6,830	132	6,963	—	6,963
台湾	10,323	—	10,323	—	10,323
中国	16,705	168	16,873	—	16,873
韓国	5,759	—	5,759	—	5,759
米国	19,526	0	19,527	—	19,527
その他	5,715	—	5,715	—	5,715
顧客との契約から生 じる収益	64,861	300	65,162	—	65,162
外部顧客への売上高	64,861	300	65,162	—	65,162
セグメント間の内部 売上高又は振替高	6	—	6	△6	—
計	64,867	300	65,168	△6	65,162
セグメント利益 又は損失(△)	16,311	△115	16,195	△432	15,763

(注) 1. セグメント利益又は損失の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用△432百万円であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3. 補足情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

当第3四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごと及び品目別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	品目	生産高 (百万円)	前年同期比 (%)
	FPD関連装置	1,708	38.2
	モータ制御機器	64	79.8
	計	40,241	85.9
ライフサイエンス事業		145	75.3
合計		40,387	85.9

(注) 1. 金額は、製造原価によっております。

(2) 受注実績

当第3四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごと及び品目別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	品目	受注高 (百万円)	前年同期比 (%)	受注残高 (百万円)	前年同期比 (%)
	分析装置	1,507	—	3,824	—
	FPD関連装置	6,408	281.3	4,553	562.5
	計	59,187	77.1	60,204	97.6
ライフサイエンス事業		897	106.6	964	110.8
合計		60,085	77.4	61,168	97.8

(注) 1. 金額は、販売価格によっております。

(3) 販売実績

当第3四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごと及び品目別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 品目	販売高 (百万円)	前年同期比 (%)
半導体関連装置	55,313	90.2
分析装置	2,370	—
FPD関連装置	2,561	47.2
モータ制御機器	120	105.8
部品・修理 他	4,495	105.2
計	64,861	91.2
ライフサイエンス事業	300	121.0
合計	65,162	91.3

(注) 1. 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先	前第3四半期連結累計期間		当第3四半期連結累計期間	
	販売高 (百万円)	割合 (%)	販売高 (百万円)	割合 (%)
Applied Materials, Inc.	13,340	18.7	16,077	24.7
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd.	7,313	10.2	—	—

(注) 1. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd. に対する当第3四半期連結累計期間の売上高は、5,235百万円（総販売実績に対する割合8.0%）であります。